

容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 关于沈阳芯源微电子设备股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的审核问询函 之回复专项核查意见

上海证券交易所:

贵所于2021年9月30日出具的《关于沈阳芯源微电子设备股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》(上证科审(再融资)[2021]75号)(以下简称“审核问询函”)已收悉。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“申报会计师”)作为沈阳芯源微电子设备股份有限公司(以下简称“芯源微”、“发行人”、“公司”)向特定对象发行股票的申报会计师,对审核问询函涉及申报会计师的相关问题进行了逐项核查,现回复如下,请予以审核(注:2021年1-9月数据未经审计)。

如无特别说明,本回复使用的简称与《沈阳芯源微电子设备股份有限公司2021年度向特定对象发行A股股票募集说明书(申报稿)》(以下简称“募集说明书”)中的释义相同。

审核问询函所列问题	黑体(不加粗)
对审核问询函所列问题的回复	宋体(不加粗)
对招募说明书的补充披露、修改	楷体(加粗)
引用原募集说明书内容	楷体(不加粗)

注:本回复中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异,这些差异是由于四舍五入造成的。

目 录

问题 4：关于前次募集资金使用	3
问题 5：关于本次募投投资金额	10
问题 6：关于收益测算	18
问题 7：关于财务性投资	23

问题 4：关于前次募集资金使用

发行人于2019年12月完成首次公开发行并上市，募集资金净额为50,574.41 万元,其中超募资金12,795.44万元，超募资金本次拟用于永久补充流动资金的金额为3,830万元，占超募资金总额的比例为29.93%。截至2021年3月31日，募投项目累计投入募集资金金额为13,264.26万元（未包含超募资金使用）。公司首次公开发行股票募集资金计划投入项目为“高端晶圆处理设备产业化项目”及“高端晶圆处理设备研发中心项目”。该等项目预计达到可使用状态日期为分别为 2021年6月10日及2020年10月10日。截至本报告签署日，该等募投项目尚未达到可使用状态，存在延期情形。“高端晶圆处理设备产业化项目”变更了实施地点。

请发行人披露：（1）前募资金的后续使用计划及预期进度、项目建设进展及后续建设情况；（2）前次募投项目与本次募投项目的差异；（3）较大金额资金未使用情况下进行本次融资的必要性及合理性。

请发行人说明：（1）截至最近一期期末，前募资金使用是否达到30%比例；（2）超募资金的使用情况及使用计划，未使用超募资金用于本次募投项目的原因。

请申报会计师核查并发表意见。

回复：

一、发行人披露

（一）前募资金的后续使用计划及预期进度、项目建设进展及后续建设情况

发行人已经在募集说明书“三、董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”之“（五）前次募集资金使用情况及本次融资的必要性及合理性”之“1、前次募集资金的实际使用情况”中补充披露如下：

“经中国证监会《关于同意沈阳芯源微电子设备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕2335号）同意注册，公司于2019年12月10日向社会公开发行人民币普通股（A股）2,100万股，募集资金总额为56,637.00万元，扣除发行费用6,062.59万元后实际募集资金净额为50,574.41万元。公司首次公开发行股票募集资金计划投入项目为高端晶圆处理设备产业化项目及高端晶圆处理设备研发中心项目。

高端晶圆处理设备产业化项目原计划建设周期 18 个月，于 2021 年 6 月 10 日前达到预定可使用状态。受到沈阳市地下铁路修建规划的影响，高端晶圆处理设备产业化项目原规划地点拟进行地下铁路修建，不再具备进行募投项目建设的条件，公司于 2020 年 4 月 24 日变更了该项目的实施地点，由“沈阳市浑南区新岛街 6 号”变更为“沈阳市浑南区东至沈本一街，南至规划地块，西至沈本大街，北至桃园一路”，履行了必要的审批程序。在募投项目实施地点变更等因素的影响下，高端晶圆处理设备产业化项目的建设进度、生产设备的采购以及安装调试工作均有所延缓。为提高募投资金利用率，根据公司实际情况及市场需求，公司拟有计划、分步骤逐步投入该项目，故将该项目的达到预定可使用状态时间调整至 2022 年 6 月 30 日。

高端晶圆处理设备研发中心项目原计划建设周期 10 个月，于 2020 年 10 月 10 日前达到预定可使用状态。由于受到国外新冠疫情、中美贸易战等因素的影响，高端晶圆处理设备研发中心项目所需的部分进口设备和材料无法正常、及时供应，该项目的设备采购以及安装调试工作有所延缓，研发项目开展情况不及预期。为提高募投资金利用率，根据公司实际情况及市场需求，公司拟有计划、分步骤逐步投入该项目，故将该项目的达到预定可使用状态时间调整至 2022 年 3 月 31 日。

截至 2021 年 9 月 30 日，高端晶圆处理设备产业化项目已累计投入募集资金占计划投入募集资金比例 58.58%，已签订采购合同金额占计划投入募集资金比例约 90%，达到预定可使用状态日期为 2022 年 6 月 30 日；高端晶圆处理设备研发中心项目已累计投入募集资金占计划投入募集资金比例 86.65%，达到预定可使用状态日期 2022 年 3 月 31 日。截至本募集说明书出具日，上述前次募投项目仍在建设过程中，不存在重大背离计划的情形。”

（二）前次募投项目与本次募投项目的差异

发行人已经在募集说明书“三、董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”之“（五）前次募集资金使用情况及本次融资的必要性及合理性”之“2、前次募投项目与本次募投项目的差异”中补充披露如下：

“前次募投项目与本次募投项目的建设都是基于公司主业所在国内半导体设备市场的需求旺盛，旨在提升公司产品的生产能力，扩大公司产业化规模，满足公司市场扩张的需要，提高公司的整体盈利能力，助力提升半导体制造行业技术水平，促进我国半导体产业健康发展。

本次募投项目与前次募投项目的主要差异对比如下：

项目	募投项目	产业化设备名称	应用领域/研发内容
本次募投项目	上海临港研发及产业化项目	前道 ArF 光刻工艺涂胶显影机、浸没式光刻工艺涂胶显影机、单片式化学清洗机	应用领域：集成电路制造前道晶圆加工环节； 研发内容：研发针对 ArF 和 ArFi 浸没式工艺机台，以及单片式化学清洗机的技术实现研究及中试
	高端晶圆处理设备产业化项目（二期）	I-line 光刻工艺涂胶显影机、KrF 光刻工艺涂胶显影机、前道 Barc（抗反射层）涂胶机	应用领域：集成电路制造前道晶圆加工环节
		后道先进封装 Bumping 制备工艺涂胶显影机	应用领域：集成电路制造后道先进封装环节
	补充流动资金	-	-
前次募投项目	高端晶圆处理设备产业化项目	I-line 光刻工艺涂胶显影机、前道 Barc（抗反射层）涂胶机、PI 涂胶显影机、单片式物理清洗机	应用领域：集成电路制造前道晶圆加工环节
	高端晶圆处理设备研发中心项目	-	研发内容：针对 Barc、I 线、KrF 工艺机台，单片式物理清洗机的研发升级，以及 ArFi 先进工艺机台的原理研究以及前瞻技术探索和储备

本次募投项目对比前次募投项目，在生产产品设计和研发内容方面有明显差异，存在不同侧重。前次募投项目中高端晶圆处理设备产业化项目主要产品为包括前道 Barc（抗反射层）涂胶机、PI 涂胶显影机、I-line 光刻工艺涂胶显影机以及单片式物理清洗机。本次募投项目中高端晶圆处理设备产业化项目（二期）项目进一步扩大了公司前道 Barc（抗反射层）涂胶机、I-line 光刻工艺涂胶显影机的产业化能力，并新增 KrF 光刻工艺涂胶显影机和后道先进封装 Bumping 制备工艺涂胶显影机的产业化能力；上海临港研发及产业化项目产业化的前道机台包括道 ArF 光刻工艺涂胶显影机、浸没式光刻工艺涂胶显影机及单片式化学清洗机，应用于更高工艺等级的前道晶圆制造领域。前次募投项目中高端晶圆处理设备研发中心项目研发内容系针对前道 Barc（抗反射层）涂胶机、I-line 光刻工艺涂胶显影机、KrF 光刻工艺涂胶显影机和单片式物理清洗机的研发升级，以及 ArF 光刻工艺涂胶显影机的原理研究和前瞻技术探索及储备。本次募投项目中上海临港研发及产业化项目的研发内容系针对 ArF 光刻工艺涂胶显影机、浸没式光刻工艺涂胶显影机及单片式化学清洗机的技术实现研究及中试。”

（三）较大金额资金未使用情况下进行本次融资的必要性及合理性

发行人已经在募集说明书“三、董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”之“（五）前次募集资金使用情况及本次融资的必要性及合理性”之“3、前次募集资金较大

金额资金未使用情况下进行本次融资的必要性及合理性”中补充披露如下：

“截至 2021 年 9 月 30 日，高端晶圆处理设备产业化项目已累计投入募集资金占计划投入募集资金比例 58.58%，已签订采购合同金额占计划投入募集资金比例约 90%，达到预定可使用状态日期为 2022 年 6 月 30 日；高端晶圆处理设备研发中心项目已累计投入募集资金占计划投入募集资金比例 86.65%，达到预定可使用状态日期 2022 年 3 月 31 日。截至本募集说明书出具日，上述前次募投项目仍在建设过程中，不存在重大背离计划的情形。剩余尚未使用的前次募集资金将按原计划用于前次募投项目，超募资金将按规定逐步用于永久补充流动资金，IPO 全部募集资金正在按照既定计划用途使用，无法用于本次募投项目。

公司本次再融资的必要性及合理性如下：

(1) 现有场地面积受限，难以满足快速增长的订单需求

报告期内，由于下游晶圆厂、封装厂产能持续扩张，公司订单量大幅增长，截至 2021 年 9 月 30 日，公司在手订单金额为 133,055.34 万元，较 2020 年末新增 56,338.79 万元，增长 73.44%。同时，2021 年 1-9 月，公司前道设备新签订单金额为 31,035.75 万元，同比新增 21,382.19 万元，增长 221.50%，随着公司前道涂胶显影设备以及清洗机的研发取得进展，未来新增前道设备订单将呈较快增长趋势。因公司在手订单大幅增长，特别是前道设备生产调试所需场地面积与后道设备和 6 英寸及以下单晶圆处理设备相比有大幅提升，公司现有厂区生产调试场地已基本趋于饱和，难以满足公司未来快速增长的排产需求。

(2) 持续提升产品工艺制程，符合公司发展战略

公司前次募投项目产业化的涂胶/显影机包括前道 Barc（抗反射层）涂胶机、PI 涂胶显影机、I-line 光刻工艺涂胶显影机，均应用于集成电路制造前道晶圆加工环节，适用于 offline、I-line 光刻工艺制程。本次募投项目中，高端晶圆处理设备产业化项目（二期）项目新增 KrF 光刻工艺涂胶显影机产业化，适用于 KrF 光刻工艺制程，工艺制程等级高于 offline 与 I-line 光刻工艺制程；上海临港研发及产业化项目新增前道 ArF 光刻工艺涂胶显影机、浸没式光刻工艺涂胶显影机产业化，适用于 ArF、浸没式光刻工艺制程，属于更高端光刻工艺制程，将进一步弥补我国在该领域的市场空白。公司将按照 offline→I-line→KrF→ArF→ArFi 的制程发展趋势，逐步实现前道涂胶显影设备向

28nm 及更高工艺制程的全覆盖。

公司前次募投项目产业化的清洗机为单片式物理清洗机，而本次募投项目中上海临港研发及产业化项目新增单片式化学清洗机，产品工艺等级和应用范围更为广泛。

公司专注于半导体专用设备的研发、生产和销售，将紧密跟踪国际先进技术发展趋势，积极向精细化前沿技术领域发展，瞄准市场空间更大的前道设备主战场。本次募投项目的建设，将进一步提升公司产品工艺制程等级，是公司提升科技创新水平、保持科技创新能力、提升市场占用率的必由之路，符合公司整体发展战略。

(3) 加速半导体设备国产化替代进程，助力半导体产业链自主可控

近年来，经济逆全球化的风险不断加大，解决国内半导体产业“卡脖子”问题、实现半导体产业链自主可控已迫在眉睫。长期以来，我国半导体设备行业市场份额仍主要由国外知名企业所占据，下游客户基于供应链安全的考虑，急需寻找其他国内合格供应商以扩展设备采买来源，控制经营风险。

通过前次募投项目和本次募投项目的建设，公司将进一步提升现有量产半导体设备的供货能力，并推出更高工艺等级的前道涂胶显影设备与清洗设备产品，确立前道产品在公司现有产品体系中的主导地位，进一步强化公司在高端设备领域的技术优势，同时也将满足下游客户对于国产高端设备的迫切需求，加速半导体设备国产化替代进程，助力半导体产业链自主可控。”

二、发行人说明

(一) 截至最近一期期末，前募资金使用是否达到 30% 比例

截至 2021 年 9 月 30 日，公司前次募集资金使用情况对照表如下：

单位：万元

募集资金净额：50,574.41	已累计使用募集资金总额：26,037.51	
变更用途的募集资金总额：不适用	各年度使用募集资金总额：	
	2019 年：0.00	
	2020 年：10,786.68	
变更用途的募集资金总额比例：不适用	2021 年 1-9 月：15,250.84	
	投资项目	截止日募集资金累计投资额
		项目达到预

序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	定可以使用状态日期
1	高端晶圆处理设备产业化项目	高端晶圆处理设备产业化项目	23,860.73	23,860.73	13,977.15	9,883.58	2022年6月30日
2	高端晶圆处理设备研发中心项目	高端晶圆处理设备研发中心项目	13,918.24	13,918.24	12,060.36	1,857.88	2022年3月31日

注：公司前次募集资金总额为56,637.00万元，扣除发行费用6,062.59万元后募集资金净额为50,574.41万元，其中计划用于募投项目金额为37,778.97万元，超募资金金额为12,795.44万元。

截至2021年9月30日，公司前次募集资金已累计使用金额为26,037.51万元，占前次募集资金中计划用于募投项目的金额比例为68.92%，前募资金使用已达到30%比例。

（二）超募资金的使用情况及使用计划，未使用超募资金用于本次募投项目的原因

1、超募资金的使用情况及使用计划

公司于2020年4月24日召开第一届董事会第十五次会议及第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，2020年5月25日，公司召开2019年年度股东大会审议通过了前述议案，同意公司使用部分超募资金人民币3,830万元用于永久补充流动资金。公司于2021年6月11日召开第一届董事会第二十六次会议和第一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，2021年6月28日，公司召开2021年第三次临时股东大会审议通过了前述议案，同意公司使用部分超募资金人民币3,830万元用于永久补充流动资金。

截至2021年9月30日，公司累计使用超募资金永久补充流动资金7,660万元。在保证前次募投项目正常进行的前提下，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益，公司计划未来将剩余超募资金5,135.44万元逐步用于永久补充流动资金。

2、未使用超募资金用于本次募投项目的原因

未使用超募资金用于本次募投项目主要系为满足公司未来营运资金需求。根据本回复“问题5”之“一、发行人说明”之“（三）结合使用前次超募资金补充流动资金的情况，量化分析本次募投用于补充流动资金规模的合理性及必要性”，公司未来三年营运

资金需求为 54,334.88 万元。截至 2021 年 9 月 30 日，公司货币资金 28,763.97 万元，其中受限货币资金（主要为保函保证金、票据保证金等）4,361.36 万元，前次募投项目尚需投入货币资金 11,741.46 万元，因此公司实际可自由支配货币资金 12,661.15 万元，且其中包括 IPO 剩余超募资金 5,135.44 万元，该部分货币资金无法满足未来三年 54,334.88 万元的营运资金需求。若将超募资金用于本次募投项目，则营运资金将进一步减少，不利于公司日常生产经营与业务发展。

综上所述，未使用超募资金用于本次募投项目主要系为满足公司未来营运资金需求，具有合理性。

三、申报会计师核查并发表意见

（一）核查程序

申报会计师履行了如下主要核查程序：

（1）获取前次募集资金银行账户对账单、资金流出相关银行回单及其他银行账户资料；

（2）获取前次募集资金使用计划，对比分析募集资金实际使用情况是否与预期相符；

（3）取得并查阅了发行人出具的相关说明，访谈了发行人管理层、销售人员，了解了发行人产品的应用领域、主要用途及分类方式；

（4）查阅了发行人就前募资金使用相关的公开披露文件。

（二）核查意见

经核查，申报会计师认为：

（1）发行人已按要求披露前募资金的后续使用计划及预期进度、项目建设进展及后续建设情况、前次募投项目与本次募投项目的差异、较大金额资金未使用情况下进行本次融资的必要性及合理性。

（2）截至 2021 年 9 月 30 日，发行人前募资金使用超过 30%比例。

（3）发行人未使用超募资金用于本次募投项目主要系为满足公司未来营运资金需求，具有合理性。

问题 5：关于本次募投投资金额

本次发行股票募集资金总额不超过 100,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后拟用于以下项目：

序号	项目名称	项目投资总额（万元）	募集资金使用金额（万元）
1	上海临港研发及产业化项目	64,000.00	47,000.00
2	高端晶圆处理设备产业化项目（二期）	28,939.27	23,000.00
3	补充流动资金	30,000.00	30,000.00
合计		122,939.27	100,000.00

请发行人说明：（1）上海临港研发及产业化项目和高端晶圆处理设备产业化项目（二期）建设投资的具体投资数额的具体测算依据和测算过程；（2）在前次募投项目延期的情况下进行本次募投项目的必要性，对本次募投项目的影响；（3）结合使用前次超募资金补充流动资金的情况，量化分析本次募投用于补充流动资金规模的合理性及必要性；（4）明确使用募集资金的具体投资明细，结合各募投项目中非资本性支出的情况，测算本次募投项目中实质用于补充流动资金的具体金额，并论证补充流动资金的比例是否超过募集资金总额的30%。

请申报会计师核查并发表明确意见。

回复：

一、发行人说明

（一）上海临港研发及产业化项目和高端晶圆处理设备产业化项目（二期）建设投资的具体投资数额的具体测算依据和测算过程

1、上海临港研发及产业化项目

序号	工程或费用名称	投资金额（万元）
1	建设投资	47,063.49
1.1	场地建设投资	28,830.84
1.1.1	土建投资	19,769.83
1.1.2	装修投资	6,591.07
1.1.3	土地购置款	2,469.94
1.2	设备及软件投资	18,232.65

序号	工程或费用名称	投资金额（万元）
1.2.1	设备投资	15,951.45
1.2.2	软件投资	2,281.20
2	预备费	1,337.81
3	研发及产业化投入	6,065.08
3.1	材料投入	3,025.00
3.2	人员薪酬	2,578.76
3.3	其他投入	461.32
4	铺底流动资金	9,533.62
5	项目总投资	64,000.00

（1）建设投资

①场地建设投资

本项目的场地建设内容主要包括装配调试区域、下夹层、仓库、动力车间、研发实验室、行政办公区域、地下建筑以及相关机电配套等，建筑面积合计 51,391.59 平方米。公司按照当地市场建筑工程实施单位成本估算，场地建设费用合计 28,830.84 万元。其中，土地购置款预算为 2,469.94 万元，系公司根据相关土地使用权出让合同约定土地成交总价 2,398.00 万元加上 3%契税所得。

②设备及软件投资

设备投资明细：

单位：万元

序号	工序	设备名称	购置金额
1	检测	particle 检测设备、晶圆金属离子检测设备、铵根离子测试仪、光学膜厚仪、TraverlerAVI、设备 UPS 和稳压控制系统、红外成像仪等	9,933.70
2	质检	在线式测量仪器成套、外轮廓测量仪、便捷式表面清洁洁净度量测仪、在线表面清洁度测试仪等	256.00
3	生产	模具等	200.00
4	办公	办公电脑等	120.00
5	仓储	货架等	41.75
6	机电	气动及冷热源系统、电气系统等	5,400.00
合计			15,951.45

软件投资明细：

单位：万元

序号	类型	软件名称	购置金额
1	研发设计类	数据处理软件、三维设计软件、计算机辅助制造软件、产品数据管理软件、电气设计软件、PLM 软件、实时操作系统等	1,876.20
2	办公管理类	ERP、Office、文档安全管理系统软件等、数据安全管理与信息安全审计系统	405.00
合计			2,281.20

(2) 预备费

按照土建投资、装修投资、设备与软件投资金额的 3%进行估算。

(3) 研发及产业化投入

单位：万元

类别	金额
材料费用	3,025.00
研发人员薪酬	2,578.76
其他	461.32
合计	6,065.08

(4) 铺底流动资金

公司根据项目预测的应收账款、存货等经营性流动资产以及应付账款等经营性流动负债，测算项目运营期各年需要垫付的流动资金，并根据运营期未来 10 年合计需要垫付的流动资金金额的 25%估算铺底流动资金。

2、高端晶圆处理设备产业化项目（二期）

序号	工程或费用名称	投资金额（万元）
1	建设投资	23,654.38
1.1	场地建设投资	16,101.17
1.1.1	土建投资	11,687.67
1.1.2	装修投资	4,413.50
1.2	设备及软件投资	7,553.21
1.2.1	设备投资	6,577.16
1.2.2	软件投资	976.05
2	预备费	709.63
3	铺底流动资金	4,575.26

序号	工程或费用名称	投资金额（万元）
4	项目总投资	28,939.27

（1）建设投资

①场地建设投资

本项目的场地建设内容主要包括装配调试区域、下夹层、仓库、动力车间、办公区域以及相关机电配套等，建筑面积合计 29,716.67 平方米。公司按照当地市场建筑工程实施单位成本估算，场地建设费用合计 16,101.17 万元。

②设备及软件投资

设备投资明细：

单位：万元

序号	工序	设备名称	购置金额
1	检测	晶圆金属离子检测设备、表面颗粒度检测仪、APS 颗粒检测 wafer、无线测温 WAFER 等	3,155.00
2	质检	在线式测量仪器成套、便捷式表面清洁洁净度量测仪、防水测试仪等	240.50
3	生产	模具	449.92
4	办公	办公电脑	120.00
5	仓储	货架	41.75
6	气动及冷热源系统	空压机及附属设备、氮气及附属设备、真空站及附属设备、锅炉（蒸汽及热水）、离心冷水机组及附属设备、Freecooling 风冷螺杆机、气动管道及附属	1,500.00
7	电气系统	变电站、出线、照明、弱电、IT、配电、其他机电设备	1,070.00
合计			6,577.16

软件投资明细：

单位：万元

序号	类型	软件名称	购置金额
1	生产设计类	三维设计软件、计算机辅助制造软件、PLM 软件、开发软件等	854.00
2	办公管理类	ERP、Office、文档安全管理系统软件、杀毒软件等	122.05
合计			976.05

（2）预备费

按照土建投资、装修投资、设备与软件投资金额的 3%进行估算。

（3）铺底流动资金

公司根据项目预测的应收账款、存货等经营性流动资产以及应付账款等经营性流动负债，测算项目运营期各年需要垫付的流动资金，并根据运营期未来 10 年合计需要垫付的流动资金金额的 15%估算铺底流动资金。

（二）在前次募投项目延期的情况下进行本次募投项目的必要性，对本次募投项目的影响

1、在前次募投项目延期的情况下进行本次募投项目的必要性

关于前次募投项目，截至 2021 年 9 月 30 日，高端晶圆处理设备产业化项目已累计投入募集资金占计划投入募集资金比例 58.58%，已签订采购合同金额占计划投入募集资金比例约 90%，达到预定可使用状态日期为 2022 年 6 月 30 日；高端晶圆处理设备研发中心项目已累计投入募集资金占计划投入募集资金比例 86.65%，达到预定可使用状态日期 2022 年 3 月 31 日。截至本回复出具日，上述前次募投项目仍在建设过程中，不存在重大背离计划的情形。

产品设计差异方面，本次募投项目对比前次募投项目存在明显区别。前次募投项目中高端晶圆处理设备产业化项目主要产品为包括前道 Barc（抗反射层）涂胶机、PI 涂胶显影机、I-line 光刻工艺涂胶显影机以及单片式物理清洗机。本次募投项目中高端晶圆处理设备产业化项目（二期）项目进一步扩大了公司前道 Barc（抗反射层）涂胶机、I-line 光刻工艺涂胶显影机的产业化能力，并新增 KrF 光刻工艺涂胶显影机和后道先进封装 Bumping 制备工艺涂胶显影机的产业化能力；上海临港研发及产业化项目产业化的前道机台包括道 ArF 光刻工艺涂胶显影机、浸没式光刻工艺涂胶显影机及单片式化学清洗机，应用于更高工艺等级的前道晶圆制造领域。

行业供求关系方面，涂胶显影设备等产品需求旺盛，公司现有产能无法满足下游客户持续增长的需求。近年来半导体行业需求庞大且持续增长，晶圆制造厂商产能持续吃紧，国内众多晶圆制造厂商纷纷布局扩产计划，作为晶圆生产线上必不可少的设备，公司生产的涂胶显影设备等产品需求旺盛，现有产能与前次募投项目扩充的产能在可预见的未来仍不能满足市场发展需求，公司仍亟待通过本次募投项目进行产能扩充。2021 年 1-9 月，公司前道设备新签订单金额为 31,035.75 万元，同比新增 21,382.19 万元，增长 221.50%，实现较快速度的增长。

产品结构转型升级方面，前道设备是公司产品结构转型升级的方向。随着公司在多个关键技术方面取得突破，相关技术成果已应用到新产品中，产品各项性能指标也在稳步提升，公司前道产品正在持续向更高工艺等级的方向发展。本次募投项目将新增 KrF 光刻工艺涂胶显影机、ArF 光刻工艺涂胶显影机、浸没式光刻工艺涂胶显影机及单片式化学清洗机等更高工艺等级设备的产业化，有利于提高公司产品竞争力，同时加速半导体设备国产化替代进程，助力半导体产业链自主可控。

综上，在前次募投项目延期的情况下进行本次募投项目具有必要性。

2、前次募投项目延期对本次募投项目的影响

本次募投项目包括上海临港研发及产业化项目、高端晶圆处理设备产业化项目（二期）以及补充流动资金，与前次募投项目高端晶圆处理设备产业化项目以及高端晶圆处理设备研发中心项目相互独立，在建设方面不存在先后关系或附属关系，上述项目将按照各自的既定规划开展相关建设工作与建成后的业务运营活动，前次募投项目延期不会对本次募投项目产生重大不利影响。

（三）结合使用前次超募资金补充流动资金的情况，量化分析本次募投用于补充流动资金规模的合理性及必要性

公司前次募集资金总额为 56,637.00 万元，其中计划用于募投项目 37,778.97 万元，发行费用 6,062.59 万元，超募资金 12,795.44 万元。公司于 2020 年与 2021 年分别使用超募资金永久补充流动资金 3,830 万元，符合上市公司每 12 个月内使用超募资金永久补充流动资金累计金额不得超过超募资金总额的 30% 的规定。

发行人未来三年的资金缺口测算基于以下主要假设：

（1）宏观经济环境和市场情况没有发生重大不利变化。

（2）2020 年度，公司营业收入增长率 54.30%，假设未来三年公司的营业收入仍能保持此增长速度。

2020 年以来，随着缺芯局面的延续，国内晶圆厂不断扩张，下游厂商对涂胶显影与单片湿法设备的需求持续扩大，与报告期前两年市场情况发生较大变化。2020 年以来，公司在集成电路前道晶圆加工、后道先进封装、化合物、MEMS、LED 芯片制造等领域的收入均有较大增长，销售订单大幅增加，预计未来收入增长率将保持在较高水平。2021 年 1-9 月，公司营业收入达到 54,718.69 万元，同比增长 158.20%，已超过 2020 年全年

水平。因此，假设公司未来三年保持 2020 年度营业收入增长率 54.30%具有一定的合理性。

(3) 假设发行人未来三年的流动资金需求等于经营性流动负债低于经营性流动资产的部分。

结合以上主要假设，采用销售百分比法测算未来营业收入增长所引起的相关经营性流动资产和经营性流动负债的变化，进而测算 2021 年至 2023 年公司流动资金缺口约为 54,334.88 万元。具体测算情况如下：

单位：万元

年度	2020 年		2021 年预测	2022 年预测	2023 年预测
	金额	占比	金额	金额	金额
营业收入	32,890.02	100.00%	50,749.22	78,305.93	120,825.86
经营性流动资产	55,416.80	168.49%	85,507.99	131,938.62	203,580.98
经营性流动负债	35,094.31	106.70%	54,150.44	83,553.99	128,923.61
流动资金占用额	20,322.49		31,357.55	48,384.63	74,657.37
未来三年资金缺口（2023 年末预计流动资金占用额-2020 年末流动资金占用额）	54,334.88				

截至 2021 年 9 月 30 日，公司货币资金 28,763.97 万元，其中受限货币资金（主要为保函保证金、票据保证金等）4,361.36 万元，前次募投项目尚需投入货币资金 11,741.46 万元，因此公司实际可自由支配货币资金 12,661.15 万元，且其中包括 IPO 剩余超募资金 5,135.44 万元，该部分货币资金无法满足未来三年 54,334.88 万元的营运资金需求。

因此，根据以上测算，本次发行使用募集资金补流 30,000.00 万元具有合理性与必要性。

(四)明确使用募集资金的具体投资明细，结合各募投项目中非资本性支出的情况，测算本次募投项目中实质用于补充流动资金的具体金额，并论证补充流动资金的比例是否超过募集资金总额的 30%

1、上海临港研发及产业化项目

序号	工程或费用名称	投资金额（万元）	是否资本性支出	拟使用募集资金金额（万元）
1	建设投资	47,063.49	是	47,000.00

序号	工程或费用名称	投资金额（万元）	是否资本性支出	拟使用募集资金金额（万元）
1.1	场地建设投资	28,830.84	是	28,767.35
1.2	设备及软件投资	18,232.65	是	18,232.65
2	预备费	1,337.81	否	-
3	研发及产业化投入	6,065.08	否	-
4	铺底流动资金	9,533.62	否	-
5	项目总投资	64,000.00	-	47,000.00

2、高端晶圆处理设备产业化项目（二期）

序号	工程或费用名称	合计（万元）	是否资本性支出	拟使用募集资金金额（万元）
1	建设投资	23,654.38	是	23,000.00
1.1	场地建设投资	16,101.17	是	15,446.79
1.2	设备及软件投资	7,553.21	是	7,553.21
2	预备费	709.63	否	-
3	铺底流动资金	4,575.26	否	-
4	项目总投资	28,939.27	-	23,000.00

本次发行股票募集资金总额不超过 100,000.00 万元（含本数），募集资金用途为上海临港研发及产业化项目、高端晶圆处理设备产业化项目（二期）和补充流动资金。其中上海临港研发及产业化项目与高端晶圆处理设备产业化项目（二期）的募集资金均计划用于场地建设与设备及软件投资，均属于资本性支出，合计拟使用募集资金 70,000.00 万元，占本次拟募集资金总额的 70%。本次募集资金拟用于补充流动资金 30,000.00 万元，属于非资本性支出，占本次拟募集资金总额的 30%。综上，本次募投项目中补充流动资金的比例未超过募集资金总额的 30%。

二、申报会计师核查并发表意见

（一）核查程序

申报会计师履行了如下主要核查程序：

（1）查阅了发行人首次公开发行时的招股说明书、再融资募集说明书、前次及本次募投项目的可行性研究报告等；

(2) 访谈公司管理层以及各募投项目负责人，了解募投项目的投资数额、建设内容、进度安排、资本性支出、效益测算、技术人员储备情况，复核募投项目的相关效益测算；

(3) 了解和查看前次募投项目进展情况；访谈了发行人的高管和相关技术人员，了解募投项目与现有业务的区别，本次募投项目建设的必要性和合理性；

(4) 核查了发行人的在手订单情况；

(5) 查阅并复核了发行人补充流动资金项目相关测算数据和过程。

(二) 核查意见

经核查，申报会计师认为：

(1) 发行人已说明上海临港研发及产业化项目和高端晶圆处理设备产业化项目（二期）建设投资的具体投资数额的具体测算依据和测算过程；

(2) 在前次募投项目延期的情况下进行本次募投项目具有必要性，前次募投项目延期不会对本次募投项目的进度产生影响；

(3) 结合使用前次超募资金补充流动资金的情况，根据测算，本次发行使用募集资金补流 3 亿元具有合理性及必要性；

(4) 发行人已明确使用募集资金的具体投资明细，结合各募投项目中非资本性支出的情况，本次募投项目中用于补充流动资金的金额为 3 亿元，未超过募集资金总额的 30%。

问题 6：关于收益测算

依据申报材料，公司通过建设上海临港研发及产业化项目，推出更高工艺等级的前道涂胶显影设备与清洗设备产品，形成前道设备主打优势产品，预计税后内部收益率为 15.81%，本次高端晶圆处理设备产业化项目（二期）建成并达产后，主要用于前道 I-line 与 KrF 光刻工艺涂胶显影机、前道 Barc（抗反射层）涂胶机以及后道先进封装 Bumping 制备工艺涂胶显影机，税后内部收益率为 20.03%。

请发行人说明：本次各募投项目收益情况的具体测算过程、测算依据，分析引用的相关预测数据是否充分考虑供给增加后对产品价格和毛利率的影响等因素。

请申报会计师核查并发表明确意见。

回复：

一、发行人说明

1、上海临港研发及产业化项目

本项目经济效益指标如下：

指标	数值	单位	假设条件
项目投资总额	64,000.00	万元	-
建设期	30	月	-
销售收入	92,700.00	万元	达产后平均值
净利润	17,548.75	万元	达产后平均值
毛利率	43.09	%	达产后平均值
净利率	18.93	%	达产后平均值
税后静态投资回收期	7.83	年	含建设期
税后内部收益率	15.76	%	所得税率 15%
税后净现值（NPV）	15,760.10	万元	基准折现率 12%

上述经济效益指标的测算基于如下依据：

（1）本项目建设期为 30 个月，第 3 年项目正式投产。

（2）销售收入预测

第 3 年项目投产，预计年收入 30,900.00 万元；第 6 年项目达产，达产后年收入为 92,700.00 万元。

序号	产品类别	明细	第 3 年	第 4 年	第 5 年	第 6 年
1	浸没式光刻工艺涂胶显影机	数量（台）	2	3	3	6
		单价（万元/台）	5,700.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00
		销售额（万元）	11,400.00	17,100.00	17,100.00	34,200.00
2	前道 ArF 光刻工艺涂胶显影机	数量（台）	1	2	2	3
		单价（万元/台）	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00
		销售额（万元）	3,500.00	7,000.00	7,000.00	10,500.00
3	单片式化学清洗机	数量（台）	4	6	8	12
		单价（万元/台）	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
		销售额（万元）	16,000.00	24,000.00	32,000.00	48,000.00

序号	产品类别	明细	第 3 年	第 4 年	第 5 年	第 6 年
合计（万元）			30,900.00	48,100.00	56,100.00	92,700.00

截至本回复出具日，上述产品均为待研发新产品，尚未实际产生销量，其未来预计销量及价格系依据下游客户产线建设进度、采购需求以及国产替代情况的了解进行合理预测。同类产品的销售价格系下游客户商业秘密，暂无法从公开渠道获取并披露，上述产品销售价格的预测系基于公司对市场情况的调研和了解，并考虑供给增加后对同类产品价格的影响，具备一定的可实现性。

（3）业绩预测

公司根据报告期内相关的产品销售价格、产品成本构成、材料与人工成本、期间费用、税率等因素对未来效益进行模拟测算，该项目投产后的预计毛利率、期间费用率与报告期的相关指标不存在重大差异，具备合理性。

单位：万元

序号	项目	第 1 年	第 2 年	第 3 年	第 4 年	第 5 年	第 6 年
1	营业收入	-	-	30,900.00	48,100.00	56,100.00	92,700.00
2	营业成本	-	-	20,043.31	29,644.82	32,868.61	52,557.83
3	毛利率	-	-	35.13%	38.37%	41.41%	43.30%
4	税金及附加	-	-	-	-	360.35	669.79
5	销售费用	-	-	2,931.71	4,563.60	5,322.62	8,795.14
6	管理费用	49.40	451.23	2,653.01	4,129.77	4,816.63	7,959.03
7	研发费用	1,328.72	3,492.36	4,264.20	6,637.80	7,741.80	12,792.60
8	其他收入	-	-	2,825.87	4,398.84	5,130.46	8,477.60
9	利润总额	-1,378.12	-3,943.58	3,833.63	7,522.85	10,120.45	18,403.21
10	所得税	-	-	-	-	-	-
11	净利润	-1,378.12	-3,943.58	3,833.63	7,522.85	10,120.45	18,403.21
12	净利润率	-	-	12.41%	15.64%	18.04%	19.85%

基于上述假设，按照 12% 的折现率计算，上海临港研发及产业化项目税后净现值为 15,760.10 万元、内部收益率 15.76%、税后静态投资回收期 7.83 年。

2、高端晶圆处理设备产业化项目（二期）

本项目经济效益指标如下：

指标	数值	单位	备注
项目投资总额	28,939.27	万元	-
建设期	30	月	-
销售收入	74,500.00	万元	达产后平均值
净利润	13,352.18	万元	达产后平均值
毛利率	43.16	%	达产后平均值
净利率	19.01	%	达产后平均值
税后静态投资回收期	7.59	年	含建设期
税后内部收益率	20.03	%	所得税率 15%
税后净现值 (NPV)	19,667.11	万元	基准折现率 12%

上述经济效益指标的测算基于如下依据：

(1) 本项目建设期为 30 个月，第 3 年项目正式投产。

(2) 销售收入预测

第 3 年项目投产，预计年收入 8,800.00 万元。第 6 年项目达产，达产后年收入为 74,500.00 万元。

序号	产品	明细	第 3 年	第 4 年	第 5 年	第 6 年
1	KrF 光刻工艺涂胶显影机	数量（台）	1	2	5	9
		单价（万元/台）	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00
		销售额（万元）	3,400.00	6,800.00	17,000.00	30,600.00
2	I-line 光刻工艺涂胶显影机	数量（台）	1	2	4	7
		单价（万元/台）	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00
		销售额（万元）	2,900.00	5,800.00	11,600.00	20,300.00
3	前道 Barc（抗反射层）涂胶机	数量（台）	1	2	5	8
		单价（万元/台）	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00
		销售额（万元）	1,700.00	3,400.00	8,500.00	13,600.00
4	后道先进封装 Bumping 制备工艺涂胶显影机	数量（台）	2	5	15	25
		单价（万元/台）	400.00	400.00	400.00	400.00
		销售额（万元）	800.00	2,000.00	6,000.00	10,000.00
合计（万元）			8,800.00	18,000.00	43,100.00	74,500.00

上述产品未来预计销量及价格系依据下游客户产线建设进度、采购需求以及国产替代情况的了解进行合理预测。同类产品的销售价格系下游客户商业秘密，暂无法从公开

渠道获取并披露，上述产品销售价格的预测系基于公司对市场情况的调研和了解，并考虑供给增加后对同类产品价格的影响，具备一定的可实现性。

（3）业绩预测

公司根据报告期内相关的产品销售价格、产品成本构成、材料与人工成本、期间费用、税率等因素对未来效益进行模拟测算，该项目投产后的预计毛利率、期间费用率与报告期的相关指标不存在重大差异，具备合理性。

单位：万元

序号	项目	第 3 年	第 4 年	第 5 年	第 6 年
1	营业收入	8,800.00	18,000.00	43,100.00	74,500.00
2	营业成本	6,782.94	12,638.52	25,484.57	42,010.73
3	毛利率	22.92%	29.79%	40.87%	43.61%
4	税金及附加	0.00	0.00	0.00	470.51
5	销售费用	834.92	1,707.79	4,089.22	7,068.37
6	管理费用	755.92	1,546.20	3,702.29	6,399.55
7	研发费用	1,214.40	2,484.00	5,947.80	10,281.00
8	其他收入	804.78	1,646.14	3,941.58	6,813.17
9	利润总额	16.59	1,269.62	7,817.71	15,083.02
10	所得税	0.00	0.00	0.00	638.96
11	净利润	16.59	1,269.62	7,817.71	14,444.06
12	净利润率	0.19%	7.05%	18.14%	19.39%

基于上述假设，按照 12%的折现率计算，高端晶圆处理设备产业化项目（二期）税后净现值为 19,667.11 万元、内部收益率 20.03%、税后静态投资回收期 7.59 年。

二、申报会计师核查并发表意见

（一）核查程序

申报会计师履行了如下主要核查程序：

（1）访谈公司管理层以及各募投项目负责人，了解募投项目的投资数额、建设内容、进度安排、资本性支出、效益测算、技术人员储备情况，复核募投项目的相关效益测算；

(2) 查阅了与本次募投项目有关的董事会文件，了解公司募集资金使用和项目建设的进度安排；

(3) 查阅了本次募投项目的可行性研究报告，访谈公司研发、财务及销售负责人，了解本次募投项目的具体投资构成、金额明细及各募投项目营业收入、营业成本、期间费用等主要指标预测条件及效益测算过程，并进行分析性复核；

(4) 查阅发行人历史期间生产经营过程中的数据，查阅发行人历史期间毛利率、期间费用率，核查募投项目的效益测算结果是否具备谨慎性及合理性。

(二) 核查意见

经核查，申报会计师认为：

发行人已说明本次各募投项目收益情况的具体测算过程、测算依据，分析引用的相关预测数据已经充分考虑供给增加后对产品价格和毛利率的影响等因素。

问题 7：关于财务性投资

请发行人说明：（1）自本次发行相关董事会决议日前六个月起至本次发行前，公司实施或拟实施的财务性投资（包括类金融投资）的具体情况；相关财务性投资金额是否已从本次募集资金总额中扣除；（2）结合相关投资情况分析公司是否满足最近一期不存在金额较大财务性投资的要求。

请申报会计师核查并发表明确意见。

回复：

一、发行人说明

（一）自本次发行相关董事会决议日前六个月起至本次发行前，公司实施或拟实施的财务性投资（包括类金融投资）的具体情况；相关财务性投资金额是否已从本次募集资金总额中扣除

公司于 2021 年 6 月 11 日召开第一届董事会第二十六次会议，审议通过了与本次发行相关的各项议案。自本次发行相关董事会决议日前六个月起至本回复出具日，公司不存在实施或拟实施的财务性投资（包括类金融投资），具体情况如下：

（1）类金融业务

自本次发行相关董事会决议日前六个月起至本回复出具日，公司不存在开展融资租赁、商业保理和小贷业务等类金融业务的情形。

(2) 投资产业基金或并购基金

自本次发行相关董事会决议日前六个月起至本回复出具日，公司不存在投资产业基金、并购基金的情形。

(3) 拆借资金

自本次发行相关董事会决议日前六个月起至本回复出具日，公司不存在向合并范围外的单位拆借资金的情形。

(4) 委托贷款

自本次发行相关董事会决议日前六个月起至本回复出具日，公司不存在委托贷款的情形。

(5) 以超过集团持股比例向集团财务公司出资或增资

自本次发行相关董事会决议日前六个月起至本回复出具日，公司未投资控股或参股财务公司，不存在以超过集团持股比例向集团财务公司出资或增资的情形。

(6) 购买收益波动大且风险较高的金融产品

自本次发行相关董事会决议日前六个月起至本回复出具日，为合理利用闲置资金，提高资金使用效率，增加资金使用收益，为公司及股东创造价值，公司存在使用闲置资金购买银行结构性存款及理财产品的情形。公司购买的银行结构性存款均为保本浮动收益产品，理财产品均为风险评级较低的非保本浮动收益产品，不属于收益波动大且风险较高的金融产品。

(7) 非金融企业投资金融业务等

自本次发行相关董事会决议日前六个月起至本回复出具日，公司不存在投资金融业务的情形。

(8) 公司拟实施的财务性投资情况

自本次发行相关董事会决议日前六个月起至本回复出具日，公司不存在拟实施财务性投资的相关安排。

综上所述，自本次发行相关董事会决议日前六个月起至本回复出具日，公司不存在实施或拟实施的财务性投资及类金融业务，本次募集资金总额不涉及需扣除相关财务性投资金额的情形。

（二）结合相关投资情况分析公司是否满足最近一期不存在金额较大财务性投资的要求

截至 2021 年 9 月 30 日，除存货、货币资金、应收账款/票据、预付款项、固定资产、在建工程、无形资产等与公司的日常生产经营活动显著相关的会计科目外，公司潜在可能涉及财务性投资且存在余额的主要资产科目情况如下：

序号	科目名称	截至 2021 年 9 月末 账面价值（万元）	主要构成	是否为财务 性投资
1	其他应收款	611.04	保证金、押金和备用金	否
2	其他流动资产	8,489.73	待抵扣进项税、预交企业所得税	否
3	其他非流动资产	1,433.24	预付设备款、预付软件款、预付工程款	否
4	长期股权投资	1,000.00	对参股公司投资	否

1、其他应收款

2021 年 9 月末，公司其他应收款主要为在建厂房的农民工工资保证金、员工备用金及订单投标履约保证金等，不属于财务性投资。

2、其他流动资产

2021 年 9 月末，公司持有的其他流动资产主要为待抵扣进项税、预交企业所得税，不属于财务性投资。

3、其他非流动资产

2021 年 9 月末，公司其他非流动资产主要为预付设备款、预付软件款和预付工程款，不属于财务性投资。

4、长期股权投资

2021 年 9 月末，公司长期股权投资是对参股公司上海集成电路装备材料产业创新中心有限公司的出资，该参股公司不属于类金融企业、产业投资基金或并购基金。公司参股创新中心旨在参与集成电路国产设备的专项研究，同时创新中心的定位也与公司业务发展目标契合，能够为公司带来产业协同效益，符合公司主营业务及战略发展方向，不

属于财务性投资。

综上所述，公司满足最近一期不存在金额较大财务性投资的要求。

二、申报会计师核查并发表意见

（一）核查程序

申报会计师履行了如下主要核查程序：

（1）查阅发行人报告期至今的董事会决议文件、信息披露公告文件，并向公司管理层了解了自本次发行相关董事会决议日前六个月起至今，以及截至 2021 年 9 月 30 日，公司是否实施或拟实施《科创板上市公司证券发行上市审核问答》所规定的财务性投资；

（2）检查发行人报告期初至 2021 年 9 月 30 日期间的财务报表、主要资产科目余额明细账，检查是否存在《科创板上市公司证券发行上市审核问答》所规定的财务性投资；

（3）获取发行人及其子公司的银行账户开立清单，公司银行账户名称、资金存放方式、余额、利率、受限情况等明细情况；获取并查阅了发行人银行流水，发行人所购买理财产品的说明书、购买及赎回理财产品的银行回单等，检查是否存在《科创板上市公司证券发行上市审核问答》所规定的财务性投资。

（二）核查意见

经核查，申报会计师认为：

（1）自本次发行相关董事会决议日前六个月起至本回复出具日，公司不存在实施或拟实施的财务性投资及类金融业务，本次募集资金总额不涉及需扣除相关财务性投资金额的情形；

（2）公司满足最近一期不存在金额较大财务性投资的要求。

本页无正文，为《容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于沈阳芯源微电子设备股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函之回复专项核查意见》之申报会计师签章页。



中国·北京

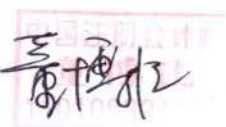
中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国注册会计师：



2021年11月3日